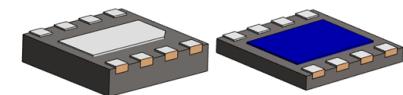


ミツミ電機株式会社
“アナログ半導体後工程（パッケージ）の生産革新実証事業”

- ◆本社所在地： 東京都
- ◆ミネベアミツミ株式会社(東京プライム上場)の100%子会社
- ◆設立年月日：1954年1月
- ◆事業内容：半導体・電子・電気機器 精密機器の製造販売
- ◆Cebu Mitsumi, Inc. が共同で事業実施

Max.0.4mm厚 Max.0.3mm厚



事業計画

フィリピンに最先端の半導体薄型パッケージ用高生産性ラインを構築し、生産性の向上を実証する

<概要>

- ・2025年1月～2028年1月まで事業実施
- ・フィリピンのセブミツミ内に最先端の半導体薄型パッケージ用高生産性ラインを構築し、増産対応とコストダウンを実現する

<期待される効果>

- ・設備自動化、プロセス清流化等の生産革新により月産50百万個（現行比1.5倍）の生産能力拡大を実現する
- ・日本とフィリピンにおいて生産能力拡大とコスト競争力強化を両立させ、サプライチェーンを強靭化させるとともに、海外への委託生産をフィリピン自社工場へ移管し経済安全保障上のリスク低減を図る